

国内グループ会社（製造関連）の新社名を決定

ローム株式会社（以下、ローム）は、グループにおける製造機能の強化および生産性向上のため、ローム滋賀工場および国内の製造関連4社を、前工程と後工程の製造会社2社に再編することを2025年10月に公表*しておりましたが、今般、新会社の社名を決定しましたので、お知らせします。

- ・前工程製造会社「ローム・デバイス マニュファクチャリング株式会社(RDM)」
- ・後工程製造会社「ローム・アッセンブリ マニュファクチャリング株式会社(RAM)」

両社は、国内で半導体をはじめとする電子部品の前工程および後工程の製造を担います。
また、ローム・アッセンブリ マニュファクチャリングは、海外の後工程製造子会社を統括するマザー会社として事業運営・管理を行っていきます。

今回の再編は、前工程と後工程の製造機能ごとに迅速かつ最適な意思決定を行うことができる体制を構築し、これまで各社が培ってきた技術やノウハウの共有による品質の向上、業務プロセスの標準化・効率化による生産性の向上を実現するとともに、最適配置や育成体制の強化による人財の活性化を図ることを目的としたものです。
ロームグループでは引き続き、事業運営の中核を担う製造機能の強化を進めることで、グローバルでの競争力を高め、市況変動に強い事業基盤を構築してまいります。

*[国内グループ（製造関連）の再編に伴う会社分割等のお知らせ](#)

■新会社の概要(予定)

	前工程製造会社	後工程製造会社
名称 (英語名称)	ローム・デバイス マニュファクチャリング株式会社 (ROHM Device Manufacturing Co., Ltd.)	ローム・アッセンブリ マニュファクチャリング株式会社 (ROHM Assembly Manufacturing Co., Ltd.)
存続会社	ローム・アポロ株式会社	ローム・ワコー株式会社
事業内容	半導体・電子部品の製造(前工程)	半導体・電子部品の製造(後工程)、 海外製造子会社(後工程)の統括/事業管理
住所	京都市右京区西院溝崎町 21	京都市右京区西院溝崎町 21
代表者	江口 英和	吉岡 浩文
資本金	450 百万円	450 百万円
業務開始日	2026 年 4 月 1 日	2026 年 4 月 1 日

以 上